STANDARD LAGENAUFBAU HDI

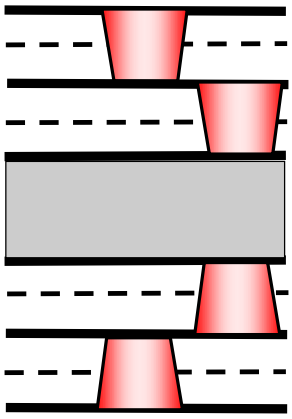
HDI06_2+2+2_1,30_35

6 - Lagen

Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**2 + 2 + 2**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
3	L2			35 µm		**33**	
			0,930 mm			**930**	
4	L3			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
5	RSK1			12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
6	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material:				1320	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,30**	+/-	0,11	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,39	+/-	0,14	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,45	+/-	0,16	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	Seite:	10+